

第3回 AM シンポジウムのご案内

主催：東京大学生産技術研究所 新野研究室

- 日時： 2013年1月22日(火) 9:30~17:30 (受付8:30から)
場所： 東京大学生産技術研究所 コンベンションホール
参加費： 無料。会場の都合により事前登録制にて先着200名とさせていただきます。
(懇談会にご参加の場合、会費5,000円ご負担ください。)

開催趣旨

2012年3月9日、米国大統領が革新的製造技術を採用対策の重点項目と位置づけ、集中的に投資することを発表した。その中で具体的に挙げられた3つの項目の中のひとつが付加製造であり、実際にNational Additive Manufacturing Innovation Institute(NAMII)が8月より正式にスタートした。本シンポジウムでは海外からの講師も招き、海外の状況、最新の技術とその応用について講演する。

プログラム

- 09:30~09:40 開会のご挨拶 東京大学教授 新野 俊樹
09:40~11:10 Additive Manufacturing in the UK: An insight into industrial and academic activity
Sheffield 大学 Neil Hopkinson
11:10~12:00 トポロジー最適化による軽量・高剛性シート構造の設計とAMによる試作
(株)豊田中央研究所 川本 敦史 氏
12:00~12:30 海外情報
東京大学 新野 俊樹
昼食・休憩(12:30~13:40)
13:40~14:30 レーザ焼結積層造形法に基づく通気性金型に関する研究
九州工業大学 檜原 弘之 教授
14:30~15:00 ファイバーレーザ搭載型積層造形装置の運用
東京都立産業技術研究センター 木暮 尊志 氏
15:00~15:30 樹脂粉末無予熱造形(仮)
東京大学 原 健太郎 氏
休憩(15:30~16:00)
16:00~16:30 Taking the next steps in AM
マテリアライズジャパン(株) 小林 貞人 氏
16:30~17:00 歯科技工への積層造形の応用
和田精密歯研(株) 樋口 鎮央 氏
17:00~17:30 RP 砂積層工法の量産実用化・金属溶融積層の可能性
(株)コイワイ 小岩井 修二 氏

* コンベンションホール「ホワイエ」にて、装置及び材料各メーカー（約10社を予定）による展示ブースを設けています。昼食・休憩時間にご自由にご見学頂けます。

懇談会（18:00～20:00） 場所：コンベンションホール内 「ホワイエ」
事前にお申込み下さい。 会費：5,000円

お申し込み方法

別紙申込書にご記入の上、下記の何れかにて事前にお申し込み下さい。
200名に達し次第締め切らせていただきます。

メール受付：amsympo@iis.u-tokyo.ac.jp

FAX受付：042-370-7901 <事務局（株）アспект 高橋 宛>

* 申込用紙は、下記URLからもダウンロード頂けます。

会場アクセス



開催場所



お問い合わせ先

シンポジウムホームページ : http://lams.iis.u-tokyo.ac.jp/am_symposium2013.html

メール問い合わせ : amsympo@iis.u-tokyo.ac.jp

事務局 : 株式会社アспект 営業部 高橋浩平

TEL : 042 - 370 - 7900

FAX : 042 - 370 - 7901

第3回AMシンポジウム参加申込書

会社名・部署・役職				
氏名				
住所				
連絡先	TEL		FAX	
	e-mail			
懇親会参加	<input type="checkbox"/> 参加する。		<input type="checkbox"/> 参加しない。	
ご意見欄				